

2013-2017年中国集成电路 封装市场竞争格局及未来发展趋势报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2013-2017年中国集成电路封装市场竞争格局及未来发展趋势报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201303/90690.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

我国集成电路封装外形尺寸，是根据国际电工委员会（IEC）第191号标准制定的，同时还参考了美国电子器件联合工程协会（JEDEC）及半导体设备和材料国际组织（SEMI）的有关标准。根据目前我国集成电路技术和生产情况，已有半导体集成电路的13类封装外形尺寸及膜集成电路和混合集成电路的14类封装外形尺寸列入了国家标准。随着技术的发展和生产的需要，将逐步增加新的内容和项目，以便不断地补充和完善。

中企顾问网发布的《2013-2017年中国集成电路封装市场竞争格局及未来发展趋势报告》共十章。首先介绍了集成电路封装相关概述、中国集成电路封装市场运行环境等，接着分析了中国集成电路封装市场发展的现状，然后介绍了中国集成电路封装重点区域市场运行形势。随后，报告对中国集成电路封装重点企业经营状况分析，最后分析了中国集成电路封装行业发展趋势与投资预测。您若想对集成电路封装产业有个系统的了解或者想投资集成电路封装行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

第一章 中国集成电路封装行业发展背景

第一节 集成电路封装行业定义及分类

一、集成电路封装行业定义

二、集成电路封装行业产品大类

三、集成电路封装行业特性分析

四、集成电路封装行业在集成电路产业中的地位分析

第二节 集成电路封装行业政策环境分析

（1）《电子信息产业调整和振兴规划》

（2）发改委加大对集成电路行业的支持力度

（3）科技部重点支持集成电路重点专项

（4）《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》

（5）海关支持软件产业和集成电路产业发展有关政策规定和措施

第三节 国内宏观经济环境分析

一、GDP历史变动轨迹分析

二、固定资产投资历史变动轨迹分析

三、2013年中国宏观经济发展预测分析

第四节 集成电路封装行业技术环境分析

一、集成电路封装技术演进分析

二、集成电路封装形式应用领域

三、集成电路封装工艺流程分析

四、集成电路封装行业新技术动态

第二章 2012年中国集成电路产业发展分析

第一节 集成电路产业发展状况

一、集成电路产业链简介

二、集成电路产业发展现状分析

(1) 行业发展势头良好

(2) 行业技术水平快速提升

(3) 行业竞争力仍有待加强

(4) 产业结构进一步优化

三、集成电路产业区域发展格局分析

(1) 三大区域集聚发展格局业已形成

(2) 整体呈现“一轴一带”的分布特征

(3) 产业整体将“有聚有分，东进西移”

四、集成电路产业面临的发展机遇

(1) 产业政策环境进一步向好

(2) 战略性新兴产业将加速发展

(3) 资本市场将为企业融资提供更多机会

五、集成电路产业面临的主要问题

(1) 规模小

(2) 创新不足

(3) 价值链整合不够

(4) 产业链不完善

六、集成电路产业“十二五”发展预测

第二节 集成电路设计业发展状况

一、集成电路设计业发展概况

二、集成电路设计业发展特征

(1) 产业规模持续扩大

- (2) 企业数量不断增长
- (3) 企业规模持续扩大
- (4) 技术能力大幅提升

三、集成电路设计业发展隐忧

四、集成电路设计业新发展策略

五、集成电路设计业“十二五”发展预测

第三章 2010-2012年中国集成电路制造行业数据监测分析

第一节 2010-2012年中国集成电路制造行业规模分析

- 一、企业数量增长分析
- 二、从业人数增长分析
- 三、资产规模增长分析

第二节 2012年中国集成电路制造行业结构分析

一、企业数量结构分析

- 1、不同类型分析
 - 2、不同所有制分析
- 二、销售收入结构分析
- 1、不同类型分析
 - 2、不同所有制分析

第三节 2010-2012年中国集成电路制造行业产值分析

- 一、产成品增长分析
- 二、工业销售产值分析
- 三、出口交货值分析

第四节 2010-2012年中国集成电路制造行业成本费用分析

- 一、销售成本统计
- 二、费用统计

第五节 2010-2012年中国集成电路制造行业盈利能力分析

- 一、主要盈利指标分析
- 二、主要盈利能力指标分析

第四章 2012年中国集成电路封装行业发展分析

第一节 半导体行业发展分析

一、半导体行业指数对比分析

- (1) 费城半导体指数与道琼斯指数

(2) 台湾电子零组件指数与台湾加权指数

(3) CSRC电子行业指数与沪深300指数

二、全球半导体产销分析

(1) 全球半导体产值情况

(2) 全球半导体销售情况

三、全球半导体行业主要企业情况

(1) 2012年全球半导体10强

(2) 全球领先半导体情况

四、中国半导体行业发展概况

五、半导体设备BB值分析

六、半导体行业景气预测

七、半导体行业发展趋势

(1) 产业链分工是方向

(2) 综合厂商向轻资产转型

(3) 封装环节产值逐年成长

(4) 封装环节外包也是趋势

第二节 集成电路封装行业发展分析

一、集成电路封装行业规模分析

二、集成电路封装行业发展现状分析

三、集成电路封装行业利润水平分析

四、大陆厂商与业内领先厂商的技术比较

五、集成电路封装行业影响因素分析

六、集成电路封装行业发展趋势及前景预测

第三节 集成电路封装类专利分析

一、专利分析样本构成

(1) 数据库选择

(2) 检索方式

二、封装类专利分析

(1) 专利公开年度趋势

(2) 国内外专利公开趋势对比

(3) 国内专利公开主要省市分布

(4) IPC技术分类趋势分布

(5) 主要权利人分布情况

第四节 集成电路封装过程部分技术问题探讨

一、集成电路封装开裂产生原因分析及对策

(1) 封装开裂的影响因素分析

(2) 管控影响开裂的因素的方法分析

二、集成电路封装芯片弹坑问题产生原因分析及对策

(1) 产生芯片弹坑问题的因素分析

(2) 预防芯片弹坑问题产生的方法

第五章 2012年中国集成电路封装行业市场需求分析

第一节 集成电路市场分析

一、集成电路市场规模

二、集成电路市场结构分析

(1) 集成电路市场产品结构分析

(2) 集成电路市场应用结构分析

三、集成电路市场竞争格局

四、集成电路国内市场自给率

五、集成电路市场发展预测

第二节 集成电路封装行业需求分析

一、计算机领域对行业的需求分析

二、消费电子领域对行业的需求分析

三、通信设备领域对行业的需求分析

四、工控设备领域对行业的需求分析

五、汽车电子领域对行业的需求分析

第六章 2012年中国集成电路封装行业市场竞争分析

第一节 集成电路封装行业竞争结构波特五力模型分析

一、现有竞争者之间的竞争

二、关键要素的供应商议价能力分析

三、消费者议价能力分析

四、行业潜在进入者分析

五、替代品风险分析

第二节 集成电路封装行业国际竞争格局分析

一、国际集成电路封装市场总体发展状况

二、国际集成电路封装市场竞争状况分析

三、国际集成电路封装市场发展趋势分析

(1) 封装技术的高密度、高速和高频率以及低成本

(2) 主板材料的变化趋势

第三节 集成电路封装行业国内竞争格局分析

第七章 2012年跨国企业在华市场竞争力分析

第一节 台湾日月光集团竞争力分析

一、企业简介

二、企业经营情况分析

第二节 美国安靠（Amkor）公司竞争力分析

一、企业简介

二、企业经营情况分析

第三节 台湾矽品公司竞争力分析

一、企业简介

二、企业经营情况分析

第四节 新加坡STATS-ChipPAC公司竞争力分析

一、企业简介

二、企业经营情况分析

第五节 力成科技股份有限公司竞争力分析

一、企业简介

二、企业经营情况分析

第六节 飞思卡尔公司竞争力分析

一、企业简介

二、企业经营情况分析

第七节 英飞凌科技公司竞争力分析

一、企业简介

二、企业经营情况分析

第八章 2012年中国集成电路封装行业产品市场分析

第一节 集成电路封装行业BGA产品市场分析

第二节 集成电路封装行业SIP产品市场分析

第三节 集成电路封装行业SOP产品市场分析

第四节 集成电路封装行业QFP产品市场分析

第五节 集成电路封装行业QFN产品市场分析

第六节 集成电路封装行业MCM产品市场分析

第七节 集成电路封装行业CSP产品市场分析

第八节 集成电路封装行业其他产品市场分析

一、晶圆级封装市场分析

二、覆晶/倒封装市场分析

三、3D封装市场分析

第九章 2012年中国集成电路封装行业主要企业调研分析

第一节 集成电路封装企业发展总体状况分析

一、集成电路封装行业制造商工业总产值排名

二、集成电路封装行业制造商销售收入排名

三、集成电路封装行业制造商利润总额排名

第二节 集成电路封装行业领先企业个案分析

一、长电科技（600584）

二、深圳赛意法微电子有限公司

三、南通富士通微电子股份有限公司

四、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司

五、英特尔产品（成都）有限公司

六、无锡菱光科技有限公司

七、恒宝股份有限公司

八、南京汉德森科技股份有限公司

九、深圳市比亚迪微电子有限公司

十、常州市欧密格电子科技有限公司

第十章 2013-2017年中国集成电路封装行业投资分析及建议

第一节 集成电路封装行业投资特性分析

一、集成电路封装行业投资壁垒

（1）技术壁垒

（2）资金壁垒

（3）人才壁垒

（4）严格的客户认证制度

二、集成电路封装行业盈利模式

三、集成电路封装行业盈利因素

第二节 集成电路封装行业投资兼并与重组分析

一、集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况

二、国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

三、国内集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

(1) 通富微电公司投资兼并与重组分析

(2) 华天科技公司投资兼并与重组分析

(3) 长电科技公司投资兼并与重组分析

四、集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析

第三节 集成电路封装行业投融资分析

一、电子发展基金对集成电路产业的扶持分析

(1) 电子发展基金对集成电路产业的扶持情况

(2) 电子发展基金对集成电路产业的扶持建议

二、集成电路封装行业融资成本分析

三、半导体行业资本支出分析

第四节 集成电路封装行业投资建议

一、集成电路封装行业投资机会分析

二、集成电路封装行业投资风险分析

三、集成电路封装行业投资建议

(1) 投资区域建议

(2) 投资产品建议

(3) 技术升级建议

图表目录：

图表：国内生产总值同比增长速度

图表：全国粮食产量及其增速

图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%）

图表：社会消费品零售总额增速（月度同比）（%）

图表：进出口总额（亿美元）

图表：广义货币（M2）增长速度（%）

图表：居民消费价格同比上涨情况

图表：工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）

图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%）

图表：农村居民人均收入实际增长速度

图表：人口及其自然增长率变化情况

图表：2012年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）

图表：2012年房地产开发投资同比增速（%）

图表：2013年中国GDP增长预测

图表：国内外知名机构对2013年中国GDP增速预测

图表：略……

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201303/90690.html>